

# 2023 TAIWAN BUSINESS ALLIANCE

## 臺灣 全球招商論壇 CONFERENCE

2023年11月27日

星期一 14:00~16:30

南港展覽館二館7樓E、F會議室

台北市南港區經貿二路2號7樓



活動網站

- 參加方式：免費活動(請務必攜帶名片)
- 洽詢專線：+886-7-6955298分機204高先生 / 分機276周先生
- 報名方式：(1)線上報名：<https://inves-taiwan.com/event/9IQ5B0EDD1S4> (於2023.10.16 上午9:00受理報名)  
(2)電子郵件：jeance@mail.mirdc.org.tw / ntou0810@mail.mirdc.org.tw  
(3)傳真報名：+886-7-6955627
- 報名截止時間：2023年11月17日(五)18時或額滿為止
- 本論壇以英文進行，會場備有中英文同步口譯

### 論壇活動摘要

#### ■ 投資意向書(LOI)簽署

集結未來三至五年對臺投資之外商與經濟部聯合簽署投資意向書，展現臺灣投資環境之信心。

#### ■ 頒發外商感謝獎座

頒贈感謝獎座予持續加碼投資臺灣及關鍵技術引進之外商，感謝協力帶動臺灣經濟成長及產業國際接軌之關鍵角色。

#### ■ 主題演講及座談

AI的興起，從晶圓代工、半導體封裝、散熱、系統組裝等供應鏈，都將雨露均霑。本論壇將邀請專家學者及跨國企業代表，進一步探討AI科技浪潮與供應鏈重組下，臺灣軟硬體產業之投資機會，以達共創商機目的。

### 議程表

13:00~14:00	報到
14:00~14:10	開幕致詞 經濟部部長
14:10~14:20	貴賓致詞 府院高層
14:20~14:40	頒發「外商感謝獎座」暨合影、簽署投資意向書(LOI)業者合影 府院高層
14:40~14:55	藝文演出
14:55~15:10	經濟部長官與(LOI)業者簽署投資意向書
15:10~15:30	中場休息
15:30~15:50	專題演講 / AI發展的現況與未來 資通訊產業跨國企業高階經理人
15:50~16:30	座談(含QA) / 全球供應鏈重組趨勢，臺灣之優勢與機會 主持人：資深學者專家或研究機構代表 與談人：跨國企業高階經理人

會議結束

※主辦單位保留議程主題及講者異動之權利